

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2025-011

圣邦微电子（北京）股份有限公司

2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 ☐不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 473,745,179 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	圣邦股份	股票代码	300661
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张勤	赵媛媛	
办公地址	北京市海淀区西三环北路 87 号 11 层 4-1106	北京市海淀区西三环北路 87 号 11 层 4-1106	
传真	010-88825397	010-88825397	
电话	010-88825397	010-88825397	
电子信箱	investors@sg-micro.com	investors@sg-micro.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司的经营范围和主营业务

公司是专注于高性能、高品质模拟集成电路研究、开发与销售的高新技术企业。产品全面覆盖信号链和电源管理两大领域，拥有 34 大类 5,900 余款可供销售产品，其中信号链类模拟芯片包括各类运算放大器、仪表放大器、比较器、SAR 模数转换器（SAR ADC）、 Δ - Σ 模数转换器（ Δ - Σ ADC）、Pipeline 模数转换器（Pipeline ADC）、数模转换器（DAC）、模

拟前端（AFE）、音频功率放大器、Audio DAC、视频缓冲器、线路驱动器、模拟开关、温度传感器、电平转换芯片、接口电路、电压基准芯片、小逻辑芯片等；电源管理类模拟芯片包括 LDO、系统监测电路、DC/DC 降压转换器、DC/DC 升压转换器、DC/DC 升降压转换器、背光及闪光灯 LED 驱动器、AMOLED 电源芯片、PMU、负载开关、过压保护、ESD/TVS、电池充放电管理芯片、电池保护芯片、马达驱动芯片、MOSFET 驱动芯片、MOSFET 等。同时，公司在信号链和电源管理两大领域的众多品类中不断推出车规级新产品。

公司的模拟芯片产品可广泛应用于工业控制、汽车电子、通讯设备、消费类电子和医疗仪器等领域，以及物联网、新能源、机器人和人工智能等新兴市场。

报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

（2）公司主要经营模式

1）盈利模式

公司通过设计、代工制造并销售自主知识产权的模拟集成电路产品，满足终端电子产品客户对高性能、高品质模拟集成电路元器件的需求，从而获得收入和利润。公司的产品需要根据市场的需求以及客户的实际应用要求，进行有针对性的定义及设计开发，并按照公司的技术标准委托代工厂商进行生产制造，经过严格的性能测试后，成为合格产品。公司所有产品均为自主研发，拥有完全自主知识产权，全部符合 REACH SVHC 和 RoHS2.0 绿色环保标准，综合性能品质达到国际同类产品的先进水平，部分关键技术指标达到国际领先。通过为客户提供优质可靠的产品、贴近的支持与服务以及良好的性价比赢得了广大客户的信任与青睐，产品销量持续增长、客户群体不断扩大。

2）研发模式

公司十分重视技术研发，将产品设计与研发能力视为最重要的核心竞争力，建立了完备的研发管理体系与流程。公司自创立以来一直坚持自主研发的发展路线，以技术创新为导向，不断加大研发投入，积累了一大批关键核心技术；同时针对市场趋势及客户需求进行技术研发，及时为目标市场客户提供具有国际竞争力的产品及产品组合；在优先保障公司现有产品技术研发的同时，积极进行下一代新技术、新产品的技术储备。报告期内，公司研发人员占公司员工总数的 74.09%，新申请专利 162 件。

3）生产模式

公司属于无晶圆厂半导体（Fabless）公司，专注于集成电路的研发与销售，将生产环节外包给专业代工厂商，即公司委托晶圆代工厂生产定制化晶圆，并交由封装测试厂进行封装测试，从而完成产品生产。公司通过严格的评估和考核标准选择合格的供应商。报告期内，公司的晶圆制造商主要为台积电。台积电拥有先进的晶圆制造工艺和稳定可靠的产品性能，是目前全球最大的晶圆代工厂商，其在晶圆代工市场占有率十几年来一直保持在 50%以上。公司自成立以来便和台积电开展业务合作并保持着良好的合作关系。同时，公司也针对部分产品工艺需求和国内晶圆代工龙头中芯国际开展了晶圆代工合作。报告期内，公司和全球排名前列的封装测试厂商如长电科技、通富微电、华天科技和嘉盛半导体等保持着长期成长、稳定可靠的合作关系。此外，公司还积极加强与供应商的资源整合，不断拓展产能来满足客户需求。另外，公司在江苏省江阴市规划建设集成电路设计测试项目也顺利竣工，2025 年投产后将承接部分特种测试业务。公司的常规封测业务仍然以外包模式进行。

4）销售模式

根据集成电路行业惯例和企业自身特点，公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。形成这一销售模式的原因：一是公司终端客户数量较多、分布较广，经销模式有利于提高销售环节的效率；二是经销商自身拥有广泛的客户资源，有利于公司产品的有效推广。报告期内公司销售收入主要来源于经销模式，预计未来几年公司仍将采用“经销为主、直销为辅”的模式进行产品销售。

报告期内的公司主要经营模式未发生重大变化。

（3）报告期内主要的业绩驱动因素

2023 年国内外经济低迷，全球宏观经济下行导致半导体销量整体放缓。进入 2024 年，全球宏观经济开始复苏，半导体行业也逐步进入周期上行阶段；同时半导体芯片市场需求也出现分化，工业、汽车芯片需求增长不及预期导致 TI、ADI 等大厂营收下滑，库存修正周期仍未完成；另一方面，随着机器人、人工智能等新兴应用的快速发展，市场对高性能半导体组件及配套芯片的需求也快速增加，为行业发展注入了新的活力，使得 2024 年全球半导体产业呈现出复苏与分化并存的特征。面对复杂的市场环境及行业周期的变化，公司积极应对所面临的挑战，紧密跟踪市场和客户需求，快速推出符合市场预期的新品，在巩固原有市场和客户的同时积极拓展新客户以及新的应用领域，为客户下一代新产品的开发提供最佳的模拟芯片解决方案。

报告期内，公司经营状况稳定，实现营业收入 334,698.31 万元，同比增加 27.96%；实现净利润 49,116.12 万元，同比增加 81.95%，其中，归属于母公司股东的净利润 50,024.79 万元，同比增加 78.17%。

1) 强化核心技术创新能力、产品种类和数量不断增加

公司拥有较强的自主研发实力和创新能力，近二十余年来持续加大研发投入，使得核心技术创新能力进一步得以强化，在信号链类模拟芯片和电源管理类模拟芯片两大领域积累了一批核心技术，推出了满足市场需求，并具有“多样性、齐套性、细化”特点的系列产品，部分产品关键技术指标达到国际领先水平。

报告期内，公司推出一批具有世界先进水平、满足市场需求的新产品，包括高精度电压基准、具有负输入电压能力的高速低边栅极驱动器、高效同步降压芯片、高隔离度高带宽双通道差分模拟开关、双向电荷泵、基于自主研发的 AHP-COT-FB 架构的 DC/DC 降压芯片、四通道 AMOLED 显示屏电源芯片、同步 DC/DC 升压芯片、PWM 控制线性调光 LED 驱动器、输入电压 60V 同步 BUCK 控制器、60nA 超低功耗 DC/DC 降压转换器芯片、高精度电流检测放大器、30kV 双向 ESD 保护器件、8 通道 14 位 1MSPS 低功耗 ADC、新一代高性能 24 位 Σ - Δ ADC、N 沟道低内阻小封装 30V/91A 功率 MOSFET、用于车载数字音频系统的 8 通道 32 位数模转换器、60V/6A 电子保险丝、低功耗 CSP 小封装高精度数字温度传感器、自动方向感应 4-Bit 双向电平转换器、支持全摆幅信号传输超低导通阻抗低失真的 SPDT 模拟开关、4 位双电源总线收发器等 700 余款，广泛覆盖到各个产品品类及细分应用领域。

研发人员的增加、经验的积累和技术实力的提升，使得公司产品种类和数量不断增加。在既有产品持续活跃的基础上，公司每年推出数百款新产品，使得公司的可销售产品数量持续累加，为公司业绩长期稳健成长提供了有力的支撑。

2) 品牌影响力进一步加强，客户拓展良好，应用领域拓宽

公司产品服务于广泛市场、广泛客户，覆盖了百余个细分市场领域、几千家客户。报告期内，伴随着品牌影响力日益加强，公司客户群持续扩大的同时，与客户合作的深度和广度也不断拓展；在市场方面，公司充分发挥产品在性能、品质和服务等各方面的竞争优势，在工业控制、汽车电子、通讯设备、消费类电子和医疗仪器等应用领域保持了稳健的发展，细分应用领域不断增加；在拓展既有市场领域的同时，公司也在物联网、新能源、人工智能、机器人等应用领域积极布局，研发相关新品，占领市场先机、拓展市场份额。

3) 集成电路市场需求强劲、发展前景广阔

2024 年，我国集成电路产业受到全球整体经济复苏缓慢等多重因素的影响增长有限，但从长远来看，信息化、智能化浪潮以及包括机器人、人工智能、新能源汽车、光伏储能等新兴产业的快速发展依然会推动着电子信息产业不断前进，其对集成电路的需求有望呈现增长势态，全球集成电路产业依然拥有广阔的发展前景。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末 增减	2022 年末
总资产	5,771,119,556.50	4,706,853,231.69	22.61%	4,347,929,613.02
归属于上市公司股东的净资产	4,609,226,482.20	3,850,547,539.29	19.70%	3,466,458,359.21
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	3,346,983,120.66	2,615,716,404.14	27.96%	3,187,549,913.33
归属于上市公司股东的净利润	500,247,943.10	280,768,286.79	78.17%	873,673,497.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	451,159,069.34	211,774,004.01	113.04%	846,673,648.30
经营活动产生的现金流量净额	549,337,594.89	170,670,822.08	221.87%	947,899,907.97
基本每股收益（元/股）	1.0619	0.6011	76.66%	1.8872
稀释每股收益（元/股）	1.0569	0.5930	78.23%	1.8534
加权平均净资产收益率	11.90%	7.63%	4.27%	29.95%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	729,044,755.89	847,380,856.38	868,409,523.52	902,147,984.87
归属于上市公司股东的净利润	54,383,429.78	124,266,317.90	106,251,879.83	215,346,315.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,453,571.12	107,680,897.24	90,497,960.78	202,526,640.20
经营活动产生的现金流量净额	-7,238,926.56	322,026,506.58	90,194,168.93	144,355,845.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☒否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,566	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,905	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称		股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况			
						股份状态	数量		
重庆鸿顺祥泰企业管理有限公司		境内非国有法人	19.08%	90,345,865.00	0.00	不适用	0.00		
重庆宝利弘雅企业管理有限公司		境内非国有法人	8.24%	39,009,322.00	0.00	不适用	0.00		
林林		境内自然人	5.13%	24,268,075.00	18,201,056.00	不适用	0.00		
弘威国际发展有限公司		境外法人	4.68%	22,148,073.00	0.00	不适用	0.00		
香港中央结算有限公司		境外法人	3.68%	17,401,552.00	0.00	不适用	0.00		
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金		其他	3.32%	15,703,630.00	0.00	不适用	0.00		
招商银行股份有限公司—银河创新成长混合型证券投资基金		其他	3.13%	14,799,915.00	0.00	不适用	0.00		
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金		其他	1.92%	9,106,375.00	0.00	不适用	0.00		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金		其他	1.78%	8,435,607.00	0.00	不适用	0.00		
中国民生银行股份有限公司—广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金		其他	1.50%	7,079,066.00	0.00	不适用	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东重庆鸿顺祥泰企业管理有限公司、重庆宝利弘雅企业管理有限公司、弘威国际发展有限公司、张勤女士、林林先生为一致行动人。 除上述一致行动人关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。							

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借股份 且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借股份 且尚未归还	
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	4,353,788	0.93%	133,900	0.03%	8,435,607	1.78%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

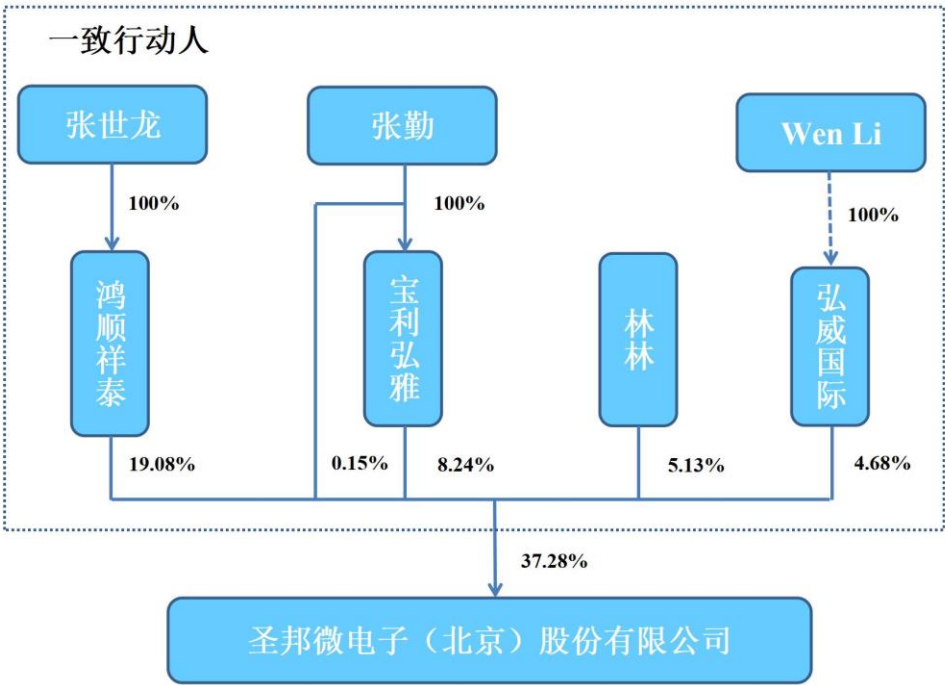
公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

1、实施 2023 年年度权益分派

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 12 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-024）。本次权益分派已于 2024 年 6 月 19 日实施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、为子公司提供担保的进展

2024 年 7 月 12 日，公司作为保证人向招商银行股份有限公司无锡分行分别出具《不可撤销担保书》《最高额不可撤销担保书》，约定由公司为全资子公司江阴圣邦微电子制造有限公司向招商银行申请 1 亿元固定资产借款以及 0.5 亿元授信额度项下债务提供连带保证责任。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、完成公司第五届董事会、监事会换届选举工作

2024 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》等相关议案，上述议案经 2024 年 9 月 19 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会逐项审议通过，完成公司第五届董事会、监事会换届选举工作。公司于同日召开第五届董事会第一次会议，完成选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员和证券事务代表的工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、实施《2023 年股票期权激励计划之预留授予》

详细内容请参阅《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”中“十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”相关阐述。